

# Cestello Per La Pulizia Di Wafer In Ptfе Da 4 Pollici, Rack Per Incisione, Resistente Ad Acidi E Alkali, Portamaschere Personalizzato

Numero articolo: PL-CP90



## introduzione

Cestelli per incisione in PTFE di precisione progettati per la pulizia di wafer semiconduttori e la lavorazione chimica. Questi rack per la pulizia resistenti agli acidi e ad alta purezza garantiscono zero contaminazione in ambienti di laboratorio impegnativi. Completamente personalizzabili per soddisfare specifiche dimensioni industriali di maschere e wafer per applicazioni avanzate di produzione e ricerca.

## Ulteriori informazioni

| Applicazione                   | Descrizione   | Vantaggio chiave  |
|--------------------------------|---|---|
| Incisione umida semiconduttori | Immergere wafer di silicio in soluzioni acide per rimuovere film sottili o pulire le superfici.           | Resistenza totale all'HF e altri incisor aggressivi garantisce zero degrado del materiale.                                    |
| Pulizia fotomaschere           | Trasportare maschere di quarzo sensibili attraverso cicli specializzati di lavaggio chimico e risciacquo. | Il contatto con materiale a basso impatto previene danni superficiali ai motivi intricati della maschera.                     |
| Fabbricazione di celle solari  | Lavorazione di wafer fotovoltaici durante le fasi di testurizzazione e pulizia della drogatura.           | L'elevata capacità di throughput e la stabilità chimica migliorano l'efficienza produttiva complessiva.                       |
| Lavorazione MEMS               | Gestione di sistemi micro-elettromeccanici attraverso diversi ambienti di incisione chimica.              | La fessurazione di precisione garantisce che componenti piccoli e fragili siano trattenuti in sicurezza durante l'agitazione. |
| Analisi di metalli in traccia  | Pulizia di vetreria e contenitori in bagni acidi ad alta purezza prima dei test analitici.                | Elimina la contaminazione incrociata fornendo un ambiente di pulizia privo di metalli.  |
| Ricerca in nanotecnologia      | Gestione di substrati sperimentali in nuove soluzioni chimiche e ambienti reattivi.                       | La versatilità in temperatura e compatibilità chimica supporta vari protocolli di ricerca.                                    |

| Caratteristica                      | Dettagli specifiche per PL-CP90                                  |
|-------------------------------------|--|
| Numero di modello                   | PL-CP90  |
| Costruzione del materiale           | PTFE ad alta purezza (Politetrafluoroetilene)                    |
| Compatibilità dimensioni wafer      | 4 pollici (Standard) / Dimensioni completamente personalizzabili |
| Configurazione fessure              | Numero di fessure e spaziatura del passo personalizzabili        |
| Resistenza chimica                  | Resistenza universale ad acidi, alcali e solventi                |
| Intervallo temperatura di esercizio | -200°C a +260°C  |
| Finitura superficiale               | Lavorato a precisione CNC / Rugosità superficiale ultra-bassa    |
| Design maniglia                     | Stili rimovibili o fissi disponibili (Personalizzabile)          |
| Design drenaggio                    | Geometria a telaio aperto ad alto flusso                         |

| Applicazione            | Descrizione   | Vantaggio chiave |
|-------------------------|---|------------------|
| Caratteristica          | Dettagli specifiche per PL-CP90                             |                  |
| Metodo di fabbricazione | Fabbricazione CNC personalizzata end-to-end                 |                  |
| Tipo di ordine          | Prodotti personalizzati basati sulle specifiche del cliente |                  |